PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-293052

(43)Date of publication of application: 16.10.1992

(51)Int.CI.

G03F 7/027 B32B 27/30 G03F 7/031 G03F 7/033 H01L 21/027 H05K 3/06

(21)Application number : 03-058747

(71)Applicant : HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

22.03.1991

(72)Inventor: ICHIKAWA TATSUYA

MINAMI YOSHITAKA KAMAKURA YUICHI

(54) PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITION AND LAMINATE USING SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the photopolymerizable composition and a photosensitive film superior in developability, a resist form, and plating resistance.

CONSTITUTION: The photopolymerizable composition is characterized by comprising an additionally polymerizable unsaturated compound having at least 2 ethylenically unsaturated double bonds in the molecule, a photopolymerization initiator, and a binder resin of a copolymer of plural components, comprising repeating units each derived from each of 3 groups of p-vinylbenzoic acid, α , β -ethylenically unsaturated carboxylic acid, and (meth)acrylate, and having a weight average molecular weight of $5 \times 104-2 \times 105$, and the photosensitive film is obtained by laminating this composition on a support film.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-293052

(43)公開日 平成4年(1992)10月16日

(51) Int.Cl. 5 G 0 3 F 7/027 B 3 2 B 27/30 G 0 3 F 7/031 7/033	8115-4F 9019-2H 9019-2H		技術表示箇所
	7352-4M		21/30 301 R <
	······································		
(21)出願番号	特顧平3-58747	(71)出願人	
(22)出顧日	平成3年(1991)3月22日		日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
/ /A	, 22 d , (1001) 0 / 100 H	(72)発明者	
			茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社山崎工場内
		(72)発明者	南 好隆
			茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社山崎工場内
		(72)発明者	
			茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
		(74)代理人	成工業株式会社山崎工場内 弁理士 若林 邦彦
		(13/10至八	7174 ATT 718

(54) 【発明の名称】 光重合性組成物及びこれを用いた積層体

(57)【要約】

【目的】 現像性、レジスト形状及び耐めっき性に優れた光重合性組成物及び感光性フィルムを提供する。

【構成】 分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和二重結合を含有する付加重合性不飽和化合物、光重合性開始剤及び結合剤を含有し、該結合剤がpービニル安息香酸、α, βーエチレン性不飽和カルポン酸及びアクリレート又はメタクリレートの各群から少なくとも1種ずつ選ばれた成分から誘導された繰り返し単位から成り、重量平均分子量が50000~20000の多元共重合体であることを特徴とする光重合性組成物及び該組成物を支持フィルム上に積層してなる感光性フィルムを提供する。

(2)

特開平4-293052

【特許請求の範囲】

【請求項1】 分子中に少なくとも2個のエチレン性不 飽和二重結合を含有する重合性不飽和化合物、光開始剤 及び結合剤を有する光重合性組成物において、前配の結 合剤が次の(A)、(B)及び(C):

1

- (A) pーピニル安息香酸
- (B) α , β エチレン性不飽和カルボン酸及び
- (C) 炭素数1~10個の脂肪族炭化水素基を有するア クリレート又はメタクリレート

の各群から少なくとも1種ずつ選ばれた成分から誘導さ 10 れた繰り返し単位から成り、重量平均分子量が5000 0~2000の多元共重合体であることを特徴とす る光重合性組成物。

【請求項2】 結合剤が、酸価60~200mg KOH/g の多元共重合体である請求項1記載の光重合性組成物。

【請求項3】 結合剤が成分(A)を5~30重量%、 成分(B)を10~30重量%及び成分(C)を40~ 85重量%含む多元共重合体である請求項1又は2記載 の光重合性組成物。

不飽和化合物7.5~55重量%及び結合剤30~80重 量%からなる請求項1、2又は3記載の光重合性組成

【請求項5】 請求項1、2、3又は4記載の光重合性 組成物の層を支持フィルム上に積層してなる積層体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、感光性樹脂組成物及び これを用いた積層体(以下、感光性フィルムと称す る。) に関し、さらに詳しくは、現像性、耐エッチング 30 性及び耐めっき性に優れた感光性樹脂組成物及び感光性 フィルムに関する。

[0 0 0 2]

【従来の技術】従来、プリント回路板の製造分野におい て、エッチング、めっき等に用いられるレジスト材料と しては、感光性樹脂組成物が広く用いられている。プリ ント回路板は感光性フィルムを銅基板上にラミネートし て、パターン露光した後、未露光部を現像液で除去し、 エッチング又はめっき処理を施して、パターンを形成さ せた後、硬化部分を基板上から剥離除去する方法によっ 40 て製造されている。

【0003】感光性フィルムを用いたプリント回路板の 製造においては、現像処理した硬化膜の形状によって、 次工程のエッチング、めっき処理後のライン形状が大き く左右されてしまうことが知られている。つまり、硬化 膜のライン形状(以下、レジスト形状と略称する)に凹 凸があれば、生産したプリント回路板の銅のライン形状 もそれに応じて凹凸が生じ、欠陥となる。

【0004】また、従来のアルカリ現像型感光性フィル ムでは、現像時間が長く、作業性に劣るものであった。

この現像時間を短縮する方法として、結合剤ポリマー中 のカルポキシル基の含有量を増加させる手法があるが、 この手法ではレジスト形状に凹凸が生じてしまい、未だ 工業的実施は困難である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記の従来 技術の問題を解決し、現像性が良好で、しかもレジスト 形状及び耐めっき性に優れた光重合性組成物及び感光性 フィルムを提供するものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の光重合性組成物 は、分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和二重結 合を含有する重合性不飽和化合物、光重合性開始剤及び 結合剤を含有し、結合剤が次の(A)、(B)、 (C):

- (A) p-ピニル安息香酸
- (B) α , β -エチレン性不飽和カルポン酸及び
- (C) 炭素数1~10個の脂肪族炭化水素基を有するア クリレート又はメタクリレート
- 【請求項4】 光重合開始剤 0.1~10重量%、重合性 20 の各群から少なくとも1種ずつ選ばれた成分から誘導さ れた繰り返し単位から成り、重量平均分子量が5000 0~2000の多元共重合体であることを特徴とす る光重合性組成物並びに支持フィルム上に前記光重合性 組成物の層を積層してなる感光性フィルムに関する。

【0007】本発明に用いる結合剤を構成する繰り返し 単位は、上記のように成分(A)、成分(B)及び成分 (C) の各群から少なくとも1種ずつ選択された成分か ら誘導されるものである。ここで、成分(A)のp-ビ ニル安息香酸の好ましい具体例としては、PVBA(北 興化学工業社製、商品名)を挙げることができる。

【0008】成分(B) のα, β-エチレン性不飽和力 ルポン酸の好ましい具体例としては、アクリル酸、メタ クリル酸、クロトン酸、イタコン酸、マレイン酸又はそ の無水物、マレイン酸モノアルキルエステル、フマル 酸、フマル酸モノアルキルエステル等を挙げることがで きる。特に好ましいのはアクリル酸又はメタクリル酸で

【0009】成分(C)は、炭素数が1~10個の脂肪 族炭化水素基を有するアクリレート又はメタクリレート である。ここで、脂肪族炭化水素基は、直鎖若しくは分 岐鎖のアルキル基又はシクロアルキル基であってよい。 成分(C)の好ましい具体例としては、メチルアクリレ ート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エ チルメタクリレート、イソプロピルアクリレート、イソ プロピルメタクリレート、イソプチルアクリレート、イ ソプチルメタクリレート、sec-プチルアクリレート、s ec ープチルメタクリレート、tertープチルアクリレー ト、tert - プチルメタクリレート、シクロヘキシルアク リレート、シクロヘキシルメタクリレート、イソポルニ 50 ルアクリレート、イソポルニルメタクリレート等を挙げ

(3)

特別平4-293052

ることができる。これらのうち、メチルアクリレート、 メチルメタクリレート、エチルアクリレート及びエチル メタクリレートが特に好ましい。

【0010】 重合体を構成する(A)、(B) 及び (C) 成分の各群には、結合剤として必要な性能を満た すために好ましい含有量の範囲がそれぞれ存在する。成 分(A)は、弱アルカリ水溶液での現像性を付与し、か つエッチング液、めっき液などの薬品に対する耐性を付 与する成分であり、結合剤の全重量基準で5~30重量 %が好ましい。成分(A) が5 重量%未満であると、現 10 像性が悪化する傾向があり、30重量%を越えると、耐 めっき性が低下する傾向がある。また、成分 (B) は、 弱アルカリ水溶液での現像性を付与するものであり、結 合剤の全重量基準で10~30重量%が好ましい。成分 (B) が10重量%未満であると、現像性が悪化する傾 向があり、30重量%を越えると、耐めっき性が低下す る傾向がある。

【0011】なお、成分(A)+成分(B)の合計量 は、15~60重量%であることが好ましい。この合計 量が15重量%未満では弱アルカリ水溶液での現像が困 20 ~ 200 0 100 100 100 100 100 100 100難であるのに対し、60重量%を越えると、光重合し、 硬化したレジスト像の弱アルカリ水溶液に対する耐性が 不足してレジスト像に欠陥を生じ易い。

【0012】一方、成分(C)は、レジストの弱アルカ リ現像液、エッチング液、めっき液などの薬品に対する 耐性を付与する成分であり、結合剤の全重量基準で40 ~85 重量%が好ましい。成分(C)が40 重量%未満 では、前記薬品への耐性が不足し、85重量%を越える

結合剤 No. 1

· 単量体	配合量(重量%)
pービニル安息香酸	5.0
メタクリル酸	1 5.0
メチルアグリレート	3 0.0
メチルメタクリレート	5 0.0
重合溶媒 ; メチルグリコール	

[0019]

[0020]

重量平均分子量 120000	
結合剤 No. 2	
単量体	_配合量(重量%)
pービニル安息香酸	1 0.0
メタクリル酸	1 0.0
エチルアクリレート	30.0
メチルメタクリレート	5 0.0
重合溶媒 ;メチルグリコール	
重量平均分子量 125000	
結合剤 No. 3	
単量体	_配合盘(重量%)

-491-

と耐アルカリ性が高すぎるため現像性が不足する傾向が ある。

【0013】本発明に用いられる結合剤は、上配の成分 (A)、(B)及び(C)を通常の方法で共重合させ、 多元共重合体として得られるものである。溶液重合によ って共重合させる場合、重合溶媒としては、メチルグリ コール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチ レングリコールモノエチルエーテルアセテート等が好ま LUL

【0014】重合開始剤としては、過酸化ベンゾイル、 アゾビスイソブチロニトリル等が使用できる。

【0015】本発明の光重合性組成物に結合剤として用 いる多元共重合体の重量平均分子量は、50000~2 00000であることを必要とする。この重量平均分子 量が50000未満であると、レジストの機械的強度、 耐現像液性、耐溶剤性、耐薬品性等が劣る。また、20 0000を越えると、現像時間が著しく長くなり、不都 合である。

【0016】また、本発明に用いる結合剤は、酸価60 い。酸価が60mg KOH/g未満であると、現像性が悪化 する傾向があり、200mg KOH/gを越えると、耐めっ き性が低下する傾向がある。

【0017】結合剤の好ましい重合体の具体例を次に示 すが、これのみに限定されるものではない。これらの重 合体は、当業者には公知の任意の重合技術により製造す ることができる。

[0018]

(4)

特開平4-293052

pービニル安息香酸	15.0
•	
メタクリル酸	5.0
メチルメタクリレート	50.0
シクロヘキシルメタクリレート	30.0

重合溶媒 ;メチルグリコール 重量平均分子量 140000

【0021】結合剤は、本発明の光重合性組成物中に3 0~80 里量%含まれることが好ましい。結合剤の含有 量が30重量%未満であると、コールドフローを起こす 傾向があり、80重量%を越えると、レジスト形状が悪 10 化する傾向がある。

【0022】本発明の光重合性組成物は、上配のような 結合剤の他に、分子中に少なくとも2個のエチレン性不 飽和二重結合を含有する付加重合性不飽和化合物及び光 開始剤を含むものである。ここで、本発明の光重合性組 成物に好適に用いられる付加重合性不飽和化合物の具体 例としては、テトラエチレングリコールジ (メタ) アク リレート(メタクリレート又はアクリレートを意味す る、以下同じ)、ポリエチレングリコールジ(メタ)ア クリレート (エチレン基の数が2~14のもの)、トリ 20 メチロールプロパンジ (メタ) アクリレート、トリメチ ロールプロパントリ (メタ) アクリレート、トリメチロ ールプロパンエトキシトリ (メタ) アクリレート、トリ メチロールプロパンプロポキシトリ (メタ) アクリレー ト、テトラメチロールメタントリ (メタ) アクリレー ト、テトラメチロールメタンテトラ (メタ) アクリレー ト、ポリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート (プロピレン基の数が2~14のもの)、ジベンタエリ スリトールペンタ (メタ) アクリレート、ジベンタエリ スリトールヘキサ(メタ)アクリレート、ピスフェノー 30 は、好ましくは光重合性組成物の総重量基準で約0.1~ ルAポリオキシエチレンジ (メタ) アクリレート、ピス フェノールAジオキシエチレンジ (メタ) アクリレー ト、ピスフェノールAトリオキシエチレンジ(メタ)ア クリレート、ピスフェノールAデカオキシエチレンジ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリグ リシジルエーテルトリアクリレート、ピスフェノールA ジグリシジルエーテルジアクリレート等が挙げられる。 付加重合性不飽和化合物は、1種又は2種以上用いても FW.

【0023】 重合性不飽和化合物の含有量は、光重合性 40 組成物の全重量基準で、好ましくは約7.5~55重量 %、より好ましくは約15~45重量%である。この含 有量が7.5重量%未満であると、レジストの機械強度、 耐現像液性、耐薬品性(例えば、耐めっき性)等が劣る 傾向がある。55重量%を越えると、密着性が低下する 傾向がある。

【0024】本発明の組成物に好適に用いられる光重合 開始剤としては、前配重合性不飽和化合物の重合を開始 させうる単一の化合物、又は2種以上の化合物を組合わ せた光重合開始剤系は全て用いることができる。好まし 50

い具体例としては、次の化合物を挙げることができる。 ペンゾフェノン、N, N'ーテトラメチルー4, 4'-ジアミノベンゾフェノン(ミヒラーケトン)、N, N' ーテトラエチルー4、4'ージアミノベンゾフェノン、 4-メトキシ-4'-ジメチルアミノベンゾフェノン、 2-エチルアントラキノン、フェナントレンキノン等の 芳香族ケトン、ペンゾインメチルエーテル、ペンゾイン エチルエーテル、ペンゾインフェニルエーテル等のペン ゾインエーテル、メチルベンゾイン、エチルベンゾイン 等のペンゾイン、2- (o-クロロフェニル)-4,5 -ジフェニルイミダゾール二畳体、2-(o-クロロフ ェニル) -4, 5-ジ (m-メトキシフェニル) イミダ ゾール二量体、2- (o-フルオロフェニル)-4,5 -ジフェニルイミダゾール二量体、2-(o-メトキシ フェニル)-4、5-ジフェニルイミダゾール二量体、 ·2- (p-メトキシフェニル) -4, 5-ジフェニルイ ミダゾール二量体、2,4-ジ(p-メトキシフェニ ル) -5-フェニルイミダゾール二量体、2-(2,4 **-ジメトキシフェニル)-4,5-ジフェニルイミダゾ** ール二量体、2-(p -メチルメルカプトフェニル)-4. 5-ジフェニルイミダゾール二量体等の2. 4. 5 - トリアリールイミダゾール二量体などが挙げられる。

6

【0025】光重合開始剤又は光重合開始剤系の含有量 10 重量%である。該配合量が少なすぎると、充分な感 度が得られず、多すぎると、露光の際に組成物の表面で の光吸収が増加して内部の光硬化が不充分となることが ある.

【0026】本発明の光重合性組成物には、必要に応じ て可塑剤、イメージング剤、密着性付与剤、熱重合禁止 剤、染料、顔料、充填剤などを配合することができる。

【0027】本発明の光重合性組成物は、金属面、例え ば、銅、ニッケル、クロム、好ましくは銅の上に、液状 レジストとして塗布して乾燥後、保護フィルムを被覆し て用いるか、又は感光性フィルムとして用いられる。光 重合性組成物層の厚みは、用途により異なるが、通常、 乾燥後の厚みで10~100μm程度である。液状レジ ストとした場合は、保護フィルムとしてポリエチレン、 ポリプロピレン等の不活性なポリオレフィンフィルムが 用いられる。感光性フィルムは、ポリエステル等の支持 フィルム上に光重合性組成物を塗布し、乾燥後、必要に よりポリオレフィン等の保護フィルムを積層して得るこ とができる。光重合性組成物は、必要に応じて他の溶剤 と混合して溶液として塗布してもよい。

(5)

特開平4-293052

【0028】前記の光重合性組成物層は、アートワーク と呼ばれるネガ又はポジマスクパターンを通して活性光 線が照射された後、現像液で現像され、レジストパター ンとされる。この際用いられる活性光線としては、例え ばカーポンアーク灯、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、キセ ノンランプ等の紫外線を有効に放射するものが用いられ る。現像液としては安全かつ安定であり、操作性が良好 なものが用いられ、例えば、一般の溶剤現像型のフォト レジストでは、1、1、1-トリクロロエタン等が、ア ルカリ現像型のフォトレジストでは炭酸ナトリウムの希 10 なお、結合剤としては、前記の結合剤 $No. \ 1 \sim 3$ 及び下 **蒋溶液等が用いられる。現像の方法には、ディップ方** 式、パドル方式、スプレー方式等があり、高圧スプレー 方式が解像度向上のためには最も適している。

*【0029】現像後に行われる電気めっきには、硫酸銅 めっき、ピロリン酸銅めっき等の銅めっき、ハイスロー はんだめっき等のはんだめっき、ワット浴(硫酸ニッケ ルー塩化ニッケル)めっき、スルファミン酸ニッケルめ っき等のニッケルめっき、ハード金めっき、ソフト金め っき等の金めっきなどがある。

[0030]

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳しく説 明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。 記の比較用結合剤 No. 4~6 のうちのいずれかを用い た。

[0031]

結合剤	No.	4
-----	-----	---

	配合量(重量%)
メタクリル酸	2 5.0
メチルアクリレート	3 0.0
メチルメタクリレート	45.0
鼠合溶媒 ; メチルグリコール	

[0032]

結合剤 No. 5

	配合量(重量%)
メタクリル酸	2 0.0
メチルアクリレート	3 0.0
エチルアクリレート 50.0	
重合溶媒 ; メチルグリコール	
重量平均分子量 10000	

[0033]

結合剤 No. 6

結合剤として、前記の結合剤 No. 1~6のうちのいずれ※

	配合量(重量%)
メタクリル酸	2 0.0
メチルメタクリレート	30.0
シクロヘキシルメタクリレート	5 0.0

重合溶媒 :メチルグリコール 重量平均分子量 130000

重量平均分子量 110000

【0034】実施例1~3及び比較例1~3

※か1種を含み、他の要素は同一の下記光重合性組成物溶 液を得た。

組	成	重量部
結合剤の35重	虽 %溶液	171.4
ペンゾフェノン		4.5
N, N' -テト	ラエチルー4,4'ージアミノベンゾフェノン	0. 1 7
ビス (N, N-	2-エチルヘキシル) アミノメチレン-5-カル	ポキシー
1, 2, 3-~	ンゾトリアゾール	0. 1
トリプロモメチ	ルフェニルスルホン	1. 0
ロイコクリスタ	ルパイオレット	1. 0
マラカイトグリ	ーン	0. 0 4
ピスフェノール	Aデカオキシエチレンジメタクリレート	40.0

【0035】次いで、この光重合性組成物溶液を25μ 50 m厚のポリエチレンテレフタレートフィルム上に均一に

(6)

特開平4-293052

塗布し、100℃の熱風対流式乾燥機で約10分間乾燥 して感光性フィルムを得た。光重合性組成物層の乾燥後 の膜厚は50μmであった。

【0036】一方、銅箔(厚さ35 μ m)を両面に積層したガラスエポキシ材である銅張り積層板(日立化成工業社製、MCL-E-61)の銅表面を#800のサンドベーパーで研磨し、水洗し、空気流で乾燥し、得られた銅張り積層板を60 Γ に加温し、その銅面上に前配の光重合性組成物層を120 Γ に加熱しながらラミネートした。

【0037】次いで、このようにして得られた基板に、ネガフィルムを使用して3kmの高圧水銀灯(オーク製作所社製、HMW-201B)で70mJ/cm²の露光を行った。次いで、ポリエチレンテレフタレートフィルムを剥ぎ取り、30℃の1重量%炭酸ナトリウム水溶液を1.0kg/cm²で60秒間スプレーすることにより未露光部を除去した。

【0038】得られた基板を下記のめっき条件でめっきした。

(a) 脱脂工程

エンプレートPC-455 (メルテックス社製) (25 容量%)、25℃で2分

(b) 水洗工程

*2~3槽、各20~40秒

(c)ソフトエッチング工程

過硫酸ナトリウム (150g/1)、25℃で2分

10

(d) 水洗工程

2槽、各20~40秒

(e)硫酸浸渍工程

10容量%、25℃で1~2分

(f) 硫酸めっき工程

メルテックス社製カッパーグリームPCM浴

10 組 成

硫酸銅 75.0g/1 硫酸 (98%) 190.0g/1 塩酸 (35%) 0.1g/1 カッパーグリームPCM 5.0ml/1

純水 全量1リットルになるまでの量

20~25℃、2.0~2.5A/dm²、50~60分

(g)水洗工程

2~3槽、各30~60秒

(h) ホウフッ化水素酸浸漬工程

20 42%ホウフッ化水素酸 (20容量%)、25℃で1~ 2分

6 4 ml / 1

2 2 ml / 1

4 0 m! / 1

20g/1

200ml/1

(i)半田めっき

メルテックス社製プルティン浴

<u>組成</u> Sn(BF4): (45%) Pb(BF4): (45%) ホウフッ化水素酸 (45%) プルテンLAスターター

ブルテンLAコンダクティビティーソルト

純水 全量1リットルになるまでの量 20~25℃、1.0~1.8A/dm²、10~18分

(j) 水洗工程

2~3槽、各30~60秒

【0039】めっき後、乾燥し、直ちにセロテープを貼り、これを垂直方向に引き剥がして(90°ピールオールオーフ試験)レジストの剥がれの有無を調べた。次いで、50℃の3重量%水酸化ナトリウム水溶液を1.5kg

/cm¹ で200秒間スプレーすることにより光硬化部分を剥離し、乾燥後、上方から光学顕微鏡でめっきもぐりの有無を観察した。これらの結果を表1に示す。

[0040]

【表1】

-494-

(7)

特開平4-293052

11

表 1

	,		
	結合剤 No.	テープテスト	もぐりの有無
実施例1	1	剝がれなし	なし
実施例2	2	剥がれなし	なし
実施例3	3	剥がれなし	なし
比較例1	4	剝がれあり	あり
比較例 2	5	剝がれあり	あり
比較例3	6	剝がれあり	あり

[0041]

【発明の効果】本発明の光重合性組成物は、プリント回

路板の製造に有用であり、現像性、レジスト形状及び耐めっき性に優れた感光性フィルムを得ることができる。

12

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別配号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H 0 1 L 21/027

H 0 5 K 3/06

H 6921-4E